

新聞稿

日期：2019年1月23日

主旨：本公司與晶元光電股份有限公司簽訂策略合作協議書

說明：

因應5G消費性電子產品廣泛應用所帶動之商機，本公司於今日(2019年1月23日)與晶元光電股份有限公司(晶電)簽署了策略合作協議書，晶電及其百分之百持股之子公司晶成半導體股份有限公司(晶成半導體)將提供本公司6吋晶圓代工服務，而本公司及本公司之子公司將提供三五族化合物半導體製程技術支援，本公司並預計於2019年第一季末之前投資取得晶成半導體普通股1640萬股，佔晶成半導體目前已發行普通股1億股之16.4%。雙方公司將分階段進行多方面代工業務合作，本公司將視後續業務發展需求，評估增加對晶成半導體之持股。此項策略合作，期能結合雙方公司產能與技術優勢，將有利於進一步擴大代工產品與客戶基礎，以達到擴大營運規模、提升獲利之目的。

晶電與晶成半導體簡介：

晶電為III-V族化合物半導體磊晶及晶粒的創新設計專業生產者，近年除致力於LED產品創新，更跨足三五族半導體之應用領域，晶電於2018年10月分割其半導體代工業務，新設持股100%之子公司晶成半導體股份有限公司，晶成主要從事 III-V 族化合物半導體元件專業代工。代工產品涵蓋面射型雷射、邊射型雷射、光通訊用檢測器及氮化鎵高功率元件。晶成半導體是國內唯一涵蓋光電及電子元件先進磊晶及晶粒製程能力之專業代工廠。